

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成31年3月28日(2019.3.28)

【公表番号】特表2018-512463(P2018-512463A)

【公表日】平成30年5月17日(2018.5.17)

【年通号数】公開・登録公報2018-018

【出願番号】特願2017-542021(P2017-542021)

【国際特許分類】

C 08 L	3/00	(2006.01)
C 08 K	5/04	(2006.01)
C 08 K	5/20	(2006.01)
C 08 L	83/04	(2006.01)
C 08 K	3/30	(2006.01)
C 08 K	3/20	(2006.01)
C 08 K	5/103	(2006.01)
C 04 B	35/636	(2006.01)

【F I】

C 08 L	3/00
C 08 K	5/04
C 08 K	5/20
C 08 L	83/04
C 08 K	3/30
C 08 K	3/20
C 08 K	5/103
C 04 B	35/636

【手続補正書】

【提出日】平成31年2月12日(2019.2.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

- a) 少なくとも1つのデンプン含有材料；
- b) 少なくとも1つの低蒸気圧極性溶媒；および
- c) 水性成分

を含む、モデリング生地であって、

水性成分c) の重量は低蒸気圧溶媒b) の重量未満であり、

成分b) は20重量%～70重量%で存在する

モデリング生地。

【請求項2】

加えて、

- d) 少なくとも1つの柔軟剤；
- e) 少なくとも1つの保存剤；
- f) 少なくとも1つの添加物

の少なくとも1つを含む、請求項1に記載のモデリング生地。

【請求項3】

成分 a) は少なくとも 1 つのデンプン含有細粉である、請求項 1 または 2 のいずれかに記載のモデリング生地。

【請求項 4】

成分 a) は、 60 % ~ 88 % のアミロペクチンを有する少なくとも 1 つの「標準細粉」および少なくとも 90 % のアミロペクチンを有する少なくとも 1 つの「ワキシー細粉」を含み、

好ましくは、前記標準細粉は、コムギ粉、ライ麦粉、タピオカ粉、トウモロコシ(コーン)粉、ジャガイモデンプン、コメ粉(とりわけ中粒および長粒コメ粉)およびそれらの混合物から選択され、

好ましくは、前記ワキシー細粉はワキシーコーンスターク、ワキシー(もち)コメ粉(とりわけ、短粒または丸粒コメのコメ粉)、ワキシージャガイモデンプンおよびそれらの混合物から選択され、

任意に 95 : 5 ~ 5 : 95 の「標準細粉」:「ワキシー細粉」比を有する
請求項 1 ~ 3 のいずれか一項に記載のモデリング生地。

【請求項 5】

成分 a) は、コメ粉(例えば、中粒または長粒コメ粉)およびもち米粉(例えば、丸粒または短粒コメ粉)の混合物を含む、ならびに / または

成分 a) は 10 ~ 60 重量 % で存在する、請求項 1 ~ 4 のいずれか一項に記載のモデリング生地。

【請求項 6】

成分 b) はアルコール、グリコール(例えばプロピレングリコール)、ポリオール(例えばグリセロール)、ケトン、エステル、アミド、例えば環状化合物、およびそれらの混合物から選択され、

好ましくは成分 b) はグリセロールであり、

任意に、成分 b) は 32 重量 % ~ 65 重量 % で存在する、請求項 1 ~ 5 のいずれか一項に記載のモデリング生地。

【請求項 7】

成分 c) は 5 ~ 45 重量 % で存在する、請求項 1 ~ 6 のいずれか一項に記載のモデリング生地。

【請求項 8】

成分 d) は存在し、少なくとも 1 つのシロキサン、少なくとも 1 つの塩、少なくとも 1 つの脂質またはそれらの混合物から選択され、ならびに / または

成分 d) は存在し、ポリジメチルシロキサン、グリセロールモノオレエートおよび / または硫酸カリウムアルミニウムを含み、

任意に、成分 d) は 1 重量 % ~ 15 重量 % の量で存在する、請求項 1 ~ 7 のいずれか一項に記載のモデリング生地。

【請求項 9】

成分 f) は 0.01 重量 % ~ 10 重量 % のレベルで存在し、界面活性剤、香り、芳香剤、色、保存剤、塩、乾燥剤、硬化剤、収斂剤、潤滑剤、手触り改変剤またはそれらの混合物を含み、

任意に、成分 f) は 0.01 重量 % ~ 10 重量 % のレベルで存在し、少なくとも 1 つのポリマを含み、

好ましくは、成分 f) は、セルロース誘導体、疎水的に改質されたセルロース誘導体、疎水的に改質されたポリアクリレート、ポリアクリル酸、キトサン、ポリビニルアルコール、ポリ (N-イソプロピルアクリルアミド)、ポリアクリルアミド、ポリエチレンオキシド、ポリビニルピロリドン、プロピレンオキシドコポリマと共に重合されたポリエチレンオキシドポリマ、ポリ酢酸ビニル - コ - ビニルアルコールおよびそれらの混合物から選択される、少なくとも 1 つのポリマを含む、請求項 1 ~ 8 のいずれか一項に記載のモデリング生地。

【請求項 10】

請求項 1 ~ 9 のいずれか一項に記載のモデリング生地および 1 ~ 40 % の少なくとも 1 つのフィラー材料を含む、充填生地。

【請求項 1 1】

i) 少なくとも 1 つのデンプン含有成分、少なくとも 1 つの低蒸気圧極性溶媒および水性成分を混合すること；

i i) 得られた混合物を加熱すること

を含む、請求項 1 ~ 9 のいずれか一項に記載のモデリング生地を形成するための方法。

【請求項 1 2】

i i i) 前記加熱混合物を練ること；および

i v) 前記加熱混合物を任意で乾燥させること

をさらに含む、請求項 1 1 に記載の方法。

【請求項 1 3】

工程 i i) は、70 ~ 99 で 5 分 ~ 4 時間の間実施される、請求項 1 1 または 1 2 に記載の方法。

【請求項 1 4】

前記水性成分を、30 ~ 70 % の相対湿度で蒸発させること、ならびに / または
グリセロールモノオレエート、脂肪酸のモノおよびジグリセリド (E 471)、ミョウ
バンおよび / もしくはポリジメチルシロキサンなどの柔軟剤を混合することをさらに含む
、請求項 1 1 ~ 1 3 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 1 5】

請求項 1 1 ~ 1 4 のいずれか一項に記載のモデリング生地を形成させ、続いて、1 ~ 40 % の少なくとも 1 つのフィラーを組み入れることを含む、充填生地を形成するための
方法。